

シリコンウェーハ向け 研磨スラリー

Nanopure™シリーズ

Nanopure™シリーズはシリコンウェーハ用ポリッシングスラリーです。高平坦性、低欠陥、高生産性などの優れた研磨性能を安定して発揮します。

概要

- ・シリコンウェーハの1次・2次及びFinal研磨やエッジ研磨に最適
- ・アルカリ性コロイダルシリカベーススラリー
- ・高研磨レート、高平坦性、低欠陥性を安定して発揮
- ・用途にマッチングした豊富なラインアップ



シリコン 1次・2次研磨用スラリー

NP6000番台

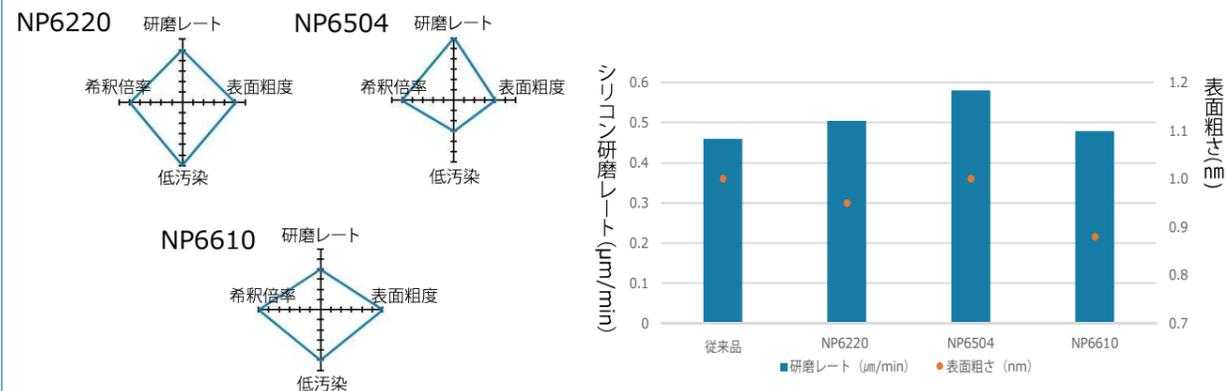
・高希釈倍率にて、高研磨レートと表面粗さ低減及び高平坦化特性を実現

NP7000番台

・2次研磨で求められる研磨レート、表面性能を高希釈倍率で達成し、Final研磨性能の向上に貢献

	NP6220	NP6504	NP6610	NP7310
主成分	高純度コロイダルシリカ	コロイダルシリカ		高純度コロイダルシリカ
砥粒濃度(wt%)	6.0	28.0	40.0	6.0
pH	11.0	11.0-13.0	11.0-12.0	10.3-11.3
砥粒サイズ(nm)	70	60-120	60-110	60-80
標準希釈倍率	20	20	30	60
研磨促進剤	アミン		アミンレス	
研磨工程	シリコン 1次~2次		バックポリッシュ	シリコン 2次
特長	超低メタル濃度	高研磨レート	高希釈	高希釈

特長



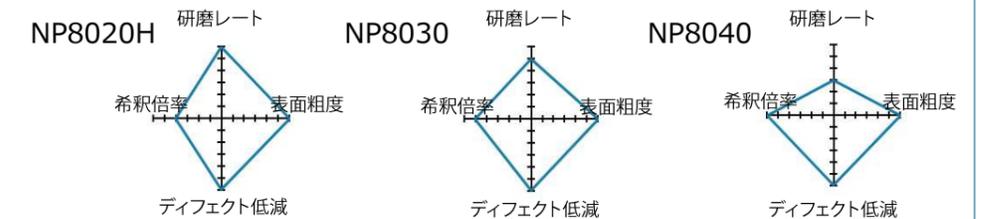
シリコン Final研磨用スラリー

NP8000番台

- ・ウェーハのダメージフリー、ヘイズフリーを実現
- ・デバイス性能に影響を及ぼす金属不純物要求を満足

	NP8020H	NP8030	NP8040	NP8100
主成分	高純度コロイダルシリカ			
砥粒濃度(wt%)	9.5	10.5	4.0	9.5
pH	10.0-11.0			8.6-9.6
砥粒サイズ(nm)	60-80			
標準希釈倍率	20	30	40	30
研磨工程	シリコン SemiFinal~Final		シリコン Final	
特長	高研磨レート 両面研磨リンス及び Final前研磨にも有効	標準品 一般シリコンウェーハの Final研磨に最適	高希釈 再生シリコンウェーハの Final研磨に最適	高希釈 ディフェクト大幅低減 先端シリコンウェーハの Final研磨に最適

特長



シリコンウェーハ エッジ研磨用スラリー

EG1103

- ・高希釈倍率においても高い加工効果
を發揮し、コスト低減に寄与

	EG1103
主成分	コロイダルシリカ
砥粒濃度(wt%)	35.0
pH	11.1-12.1
砥粒サイズ(nm)	80-140
標準希釈倍率	30
研磨工程	エッジ研磨
特長	酸化膜を効果的に除去

※その他、本カタログ掲載以外の各種スラリーを数多く取り揃えていますので、お気軽にご相談ください。

梱包形態

クリーンペールに20kg充填してお届けします。
ドラム、コンテナのご用意もございます。

